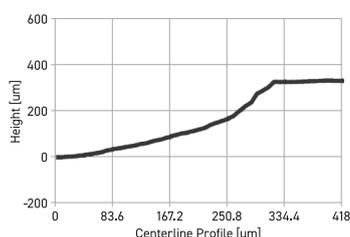


# 最新 SAKIのはんだ検査ソリューション

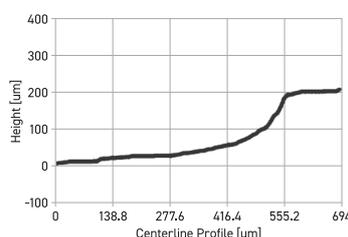
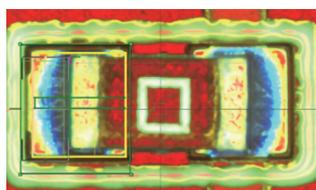
実装基板製造において、部品の微細化や高密度実装基板の増加によりはんだ検査の難易度が高まっています。それに伴いIPC基準のはんだ品質保証検査が求められます。これに対してサキの3D-AOIは、はんだ専用の新アルゴリズムで属人性なく高精度なはんだ検査を実現します。

## New はんだ検査専用アルゴリズム『フィレット形状』をリリース

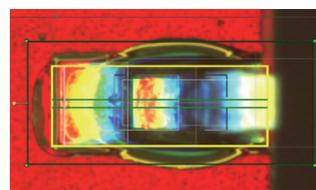
- ✓ 様々な部品種別のはんだ検査を高精度に実現します。
- ✓ IPC基準検査と不濡れ検査が可能です。
- ✓ シンプルな設定で多様な電極種別に対応し自動検査を行います。



チップ部品のはんだ形状プロフィール画像



ICリードのはんだ形状プロフィール画像



## 高精度なはんだ検査を実現する、サキの独自技術

### Key Feature1

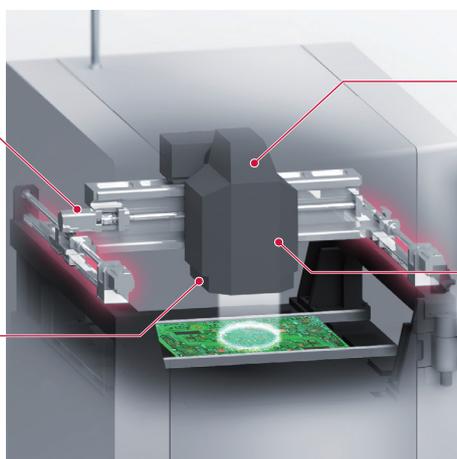
#### 高剛性ガントリー構造

- ツインモータードライブ構造による高い位置決め精度
- 高精度リニアスケールによる正確な停止精度
- ➔ はんだ計測検査の繰り返し精度を向上

### Key Feature2

#### 高度な画像処理技術

極小PAD内部のはんだ計測検査が可能



### Key Feature3

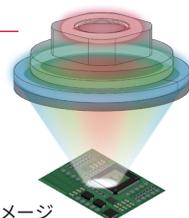
#### 8um高解像度カメラ

0201mm部品や狭ピッチ、狭パッド検査に対応

### Key Feature4

#### ドーム照明

はんだ検査における視認性の向上



ドーム照明イメージ

## 更なる高品質なはんだ検査を必要とするお客様に...

### 3D-CT AXI X線検査装置 / 3Xi-M110

IC部品等フィレットの位置、高さ、幅、角度、量の変化から良否の判定を実施。3D-AOIでは見えないバックフィレットや不濡れリードのフィレット形状を可視化。



不濡れのリードのフィレット部分積算画像

